

	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日		△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△	1	DIS-H-03768 (06159)	梅原		24.03.29	△					
△						△					
適用規格											
定格	使用温度範囲	-35℃~+85℃(注1)		保存温度範囲	-10℃~+60℃						
	電圧	AC 250V		適合コネクタ	DF1B-20DS-2.5RC						
	電流	AWG20~24: 3A AWG26: 2A AWG28: 1A AWG30: 0.5A									
性能											
	項目	試験方法		規格		QT	AT				
構造	外観、構造及び仕 上げ	目視、寸法測定器にて測定する。		図面と合致していること。		○	○				
	表示	目視にて確認する。				○	○				
電気的 性能	低電圧、低電流下 の接触抵抗	100mA (DC又は1000 Hz) で測定する。		30 mΩ以下		○	—				
	絶縁抵抗	DC 500 Vで測定する。		1000 MΩ以上		○	—				
	耐電圧	AC 650 Vの電圧を1分間印加する。		せん絡・絶縁破壊がないこと。		○	—				
機械的 性能	繰り返し動作	30 回の抜き差しを行う。		① 接触抵抗: 30 mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—				
	耐振性	周波数 10 ~ 55 Hz, 片振幅0.75mmで 3方向 各2時間試験する。		① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—				
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² , 持続時間 11 ms, 正弦半波 3 方向 各 3 回試験する。		① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗: 30 mΩ以下 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—				
環境 性能	定常状態の耐湿性	温度 40±2℃, 湿度 90~95% 中に 96 時間放置する。		① 接触抵抗: 30 mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—				
	温度サイクル	温度 -55 → 5~35 → 85 → 5~35 ℃ 時間 30 → 5以内 → 30 → 5以内 分 を 5 サイクル試験する。		① 接触抵抗: 30 mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—				
	はんだ耐熱性	【70-半田付けの場合】 はんだ温度 260 ℃, 5 秒間 で試験する。 【手半田付けの場合】 はんだこて温度 300℃, 3秒 で試験する。 但し、端子に力を加えないこと。		外観の変形及び端子などの著しい ガタがないこと。		○	—				
	はんだ付け性	はんだ温度 235 ℃, 浸漬時間 5 秒間 のはんだ付けを行う。		半田浸せき面の 95% 以上が新しい はんだでぬれていること。		○	—				
備考 (注1) 通電による温度上昇を含む。						製図	設計	検図	承認	出図	
						NC	NC	NC	NC		
						'03.04.02	'03.04.04	'03.04.10	'03.04.10		
						松木	伝法谷	宮崎	宮崎		
試験規格の記載のない試験方法は JIS C 5024を適用している。											
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目											
ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.			製品規格表			製品名 DF1BZ-20DP-2.5DS					
旧CL CL		図番 SLC4-301856-00		製品コード CL541-2059-0				1 1			